PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-008432

(43) Date of publication of application: 12.01.1996

(51)Int.CI.

H01L 29/786

(21)Application number: 06-141812

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

23.06.1994

(72)Inventor: MINAMINO YUTAKA

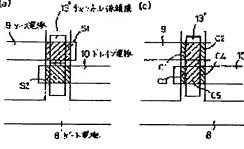
YAMAMOTO HIDETSUGU WAKIMOTO TATSUYA KIMURA MUTSUMI TAKUBO YONEJI

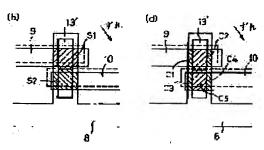
(54) THIN FILM TRANSISTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a thin film transistor which can (a) improve display quality of a liquid crystal panel, by eliminating irregularity of parasitic capacitance of a thin film transistor.

CONSTITUTION: The channel protecting film 13' of a thin film transistor is formed only on a gate electrode 8. A source electrode 9 and a drain electrode 10 intersect only the two facing sides of a region formed by the channel protecting film 13', and do not overlap with the other sides. The source electrodes 9 and the drain electrode 10 crosswise interset the gate electrode 8. By this constitution, the value of a parasitic capacitance generated in the part where the thin film transistor is formed can be made constant.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.01.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3030751

[Date of registration]

10.02.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-8432

(43)公開日 平成8年(1996)1月12日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 29/786

9056-4M

H01L 29/78

311 S

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出魔日

特顏平6-141812

平成6年(1994)6月23日

(71)出願人 000005821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 南野 裕

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 山元 英嗣

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 脇本 竜也

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

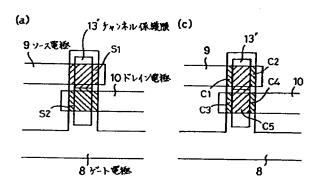
産業株式会社内

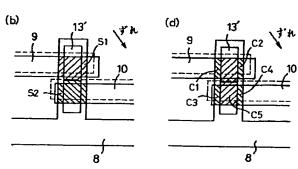
最終頁に続く

(57)【要約】

【目的】 薄膜トランジスタの寄生容量のばらつきをな くし、液晶パネルの表示品質を向上させる薄膜トランジ スタを提供する。

【構成】 薄膜トランジスタのチャンネル保護膜13′は ゲート電極8上のみに形成され、ソース電極9およびド レイン電極10がチャンネル保護膜13′の形成している領 域の対向する2辺のみとクロスオーバーし、他の辺上に は重なっておらず、かつソース電極9およびドレイン電 極10ともゲート電極8と十字型にクロスオーバーしてい る。この構成により、薄膜トランジスタを形成する部分 に発生する寄生容量の値は、マスクのアラインメント精 度によらず一定とすることができる。





.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膜トランジスタのチャンネル領域下部に走査電極を形成するようにバターンニングされたゲート電極と、液晶を駆動するため透明導電膜より成る画素電極に画像信号を伝達するソース電極(あるいはドレイン電極)と、前記画素電極と接続されたドレイン電極(あるいはソース電極)とを有する薄膜トランジスタにおいて、前記薄膜トランジスタのチャンネル保護膜は前記ゲート電極上にのみ形成され、前記ソース電極およびドレイン電極が前記チャンネル保護膜を形成している領域の対向する2辺のみとクロスオーバーして他の辺上には重なっておらず、かつ前記ソース電極およびドレイン電極は共に前記ゲート電極とも十字型にクロスオーバーとなる構造を有することを特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項2】 薄膜トランジスタのチャンネル領域下部に走査電極を形成するようにパターンニングされたゲート電極と、液晶を駆動するため透明導電膜より成る画素電極に画像信号を伝達するソース電極(あるいはドレイン電極)と、前記画素電極と接続されたドレイン電極(あるいはソース電極)とを有し、前記チャンネル領域を形成する半導体層が絶縁性基板の裏面からの露光により前記ゲート電極上に自己整合的に形成される薄膜トランジスタにおいて、前記ソース電極およびドレイン電極が共に前記チャンネル領域上で十字型にクロスオーバーとなる構造を有することを特徴とする薄膜トランジスタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、アクティブマトリックス液晶ディスプレイに用いられる薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor)の構成に関するものである。

[0002]

【従来の技術】薄膜トランジスタ(以下、TFTという) を用いたアクティブマトリックス型表示基板を用いたディスプレイは、単純マトリックス型表示基板を用いたディスプレイ装置に比べて高い画質が得られるため、盛ん* *に研究されている。

【0003】図4は従来のアクティブマトリクス液晶ディスプレイの液晶パネル部を模式的に示した透視図である。図4において、1は走査線、2はデータ線、3はTFT、4は液晶駆動用の画素電極、5はガラス基板、6は透明導電膜からなる対向電極、7は対向基板、8は走査線1と接続されたゲート電極、9はデータ線2と接続されたソース電極(あるいはドレイン電極であるが、ここでは説明のためソース電極とする)、10は画素電極4に電気的に接続されたドレイン電極(ソース電極9に対する)である。

2

【0004】通常透過型の液晶ディスプレイ装置においては、裏面光源からの光を透過させる必要があるので、 画素電極4,対向電極6は透明導電膜でなければならない。また、走査線1,データ線2,TFT3,画素電極4の素子は、これらを形成する側のガラス基板5に薄膜形成、選択エッチング等を繰り返すことにより形成される。

【0005】液晶パネルにカラー表示を行わせる場合は、対向基板7にガラス基板5上の各々の画素に対応したカラーフィルターを形成することにより表示させることができる。このような液晶パネルにおいて、画像信号に応じてTFT3を駆動し、液晶層に印加する電圧を変化させると、それに応じて液晶パネルの透過率が変化し画像の表示を行うことができる。

【0006】次に液晶パネルのチャンネル保護型TFT アレイの作製プロセスを図を用いて説明する。図5は作 製プロセスの断面図、図6はその平面図を示し、図5に おいて、4′は透明電極となる透明導電膜のITO(Ind 30 ium Tin Oxide)膜層、8′は走査線1,ゲート電極8と なるCr層、11はSiNx(Si窒化膜)の絶縁層、12はa – Si(アモルファスSi)の半導体層、13はSiNxのチャン ネル保護層、

[0007]

【外1】

13' はチャンネル保護膜、14はn + a - Si(n型アモルファスSi)のオーミック

層、15は画素電極4とコンタクトを取るための穴、16はデータ線2、ソース電極

9, ドレイン電極10となるA1層である。

[0008] (図5(a))ガラス基板5にスパッタ法でCr 40 ※ [0012] (図5(e))次にプラズマCVD法で絶縁層1層8 * を1000 A 堆積する。 1としてSiNxを4000 A、半導体層12としてa-Siを10

【0009】(図5(b)) Cr層8 ² を走査線1, ゲート電極8のパターンを残すようにエッチングを施す(図6(a))。

【0010】(図5(c))ガラス基板5上にDCスパッタ 法でITO膜層4′を1000A堆積する。

【0011】(図5(d)) I T O 膜層 4 ['] を 画素電極 4 の パターンを残すようにエッチングを施す(図6(b))。 ※

※【0012】(図5(e))次にフラスマしてり法で紀縁間1 1としてSiNxを4000Å、半導体層12としてa-Siを10 00Å、チャンネル保護層13としてSiNxを1000Å堆積する。

【0013】(図5(f))チャンネル保護層13を、フォトリソグラフィー工程にてエッチングを施し、チャンネル保護膜13′となるパターンを形成する(図6(c))。

[0014]

[外2]

(図5(g))オーミック層14としてn + a - Siを500A堆積する。

【0015】(図5(h))絶縁層11に穴15をあける(図6 50 (d))。

3

【0016】(図5(i))DCスパッタ法でA1層16を7000 A堆積する。

【0017】(図5(j))A1層16を選択エッチングしてソ ース電極9,ドレイン電極10を形成する。

[0018]

[外3]

(図5(k))n + a - Siをエッチング除去する(図6(e))。

【0019】以上のプロセスによりTFTアレイが形成されたガラス基板5上に配向膜、液晶層を形成し封入した後、ブラックマトリクス、カラーフィルター等が形成 10された対向基板7を張り合わせることにより液晶パネルが完成する。

*るために前記のチャンネル保護膜13′をなくすとともに、半導体層12のパターニングをガラス基板5裏面からの露光により、ゲート電極8の形状にパターニングする自己整合型TFTの開発も盛んに行われている。この場合の作製プロセスは以下のようになる。図7は作製プロセスの断面図、図8にその平面図を示し、13″はチャンネル領域である。

【0021】(図7(a))~(図7(d))のガラス基板5にゲート電極8, 画素電極4を形成するまではチャンネル保護膜13′を作製する場合と同一である。

[0022]

【外4】

【0020】さらに近年、TFT3をより小さく作製す*

(図7(e))プラズマCVD法で絶縁層11としてSiNxを4000人、半導体層12としてa-Siを1000人、オーミック層14としてn * a-Siを500人堆積する。

【0023】(図7(f))チャンネル領域13ⁿ のパターン を形成するように、フォトリソグラフィー工程にてエッ チングを施す(図8(c))。

【0024】(図7(g))絶縁層11に穴15をあける(図8(d))。

※Å堆積する。

【0026】(図7(i))A1層16を選択エッチングしてソ ース電極9,ドレイン電極10を形成する。

20 [0027] [外5]

【0025】(図7(h))DCスパッタ法でA1層16を7000※

(図7(j))チャンネル領域13" 上のn + a - Si層をエッチング除去する(図8(a))。

【0028】図9はチャンネル保護膜13′を有する逆スタガー型トランジスタの平面図を示し、S1はゲートーソース間の寄生容量のGS領域、S2はゲートードレイン間の寄生容量のGD領域である。チャンネル保護膜13′を有した構造では図9(a)に示した斜線部のGS領域30S1およびGD領域S2の部分で、ゲート電極8上の絶縁層11を誘電体としてゲート電極8とソース電極9およびドレイン電極10の間に寄生容量が形成される。

【0029】この寄生容量の値は、ゲート電極8のパターン、チャンネル保護膜13′のパターンおよびソース電極9,ドレイン電極10のパターンにより決定される。ここでチャンネル保護膜13′のパターンによりこの寄生容量が変化する理由は、TFT3の活性状態においてはチャンネル保護膜13′は導電体として作用するため、GS領域S1およびGD領域S2はチャンネル保護膜13′のパターンの中央により分離されるためである。

【0030】また、図10にガラス裏面からの露光によりチャンネル領域13″をゲート電極8上に自己整合的に形成した薄膜トランジスタの平面図を示す。自己整合型TFTでの寄生容量の値は、図10(a)に示すようにゲート電極8のパターンおよびソース電極9,ドレイン電極10のパターンにより決定される。

【0031】一般的にアクティブマトリクス基板作製の 過程で、それぞれのレイヤー間でパターンニングのずれ が生じる。例えば、図9(b)に示すように矢印方向にず れが生じた場合はGS領域S1は減少し、GD領域S2は増加する。逆にずれた場合は、GS領域S1は増加しGD領域S2は減少する。すなわちTFT3の寄生容量はそれぞれのパターンのずれにより変化する。また同様に、自己整合型TFTにおいても、図10(b)に示すように矢印方向にずれが生じた場合はGS領域S1は増加し、GD領域S2は減少する。

【0032】これらのパターンニングのずれの主な原因は露光時でのアラインメントずれ、フォトマスク自身のゆがみ等に起因する。このような課題に対して特開平1-267617号公報に表されるように、TFT3の形状をコの字型にして、基板内あるいは基板間の寄生容量のばらつきを抑える構造が提案されている。

[0033]

7 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような構成のTFTにおいて、前記の寄生容量のばらつきが同一基板内で発生した場合に、例えばステッパーにより表示画素を分割して露光する場合など図11に示すように、この露光境界線が認識され表示品位を落とす。また基板間で寄生容量がばらつく場合では、回路常数を一定とすることができず表示品質がばらつき、画質低下の一因となる。

【0034】また、これらのパターンずれの主な原因は 露光時でのアラインメントずれ、フォトマスク自身のゆ 50 がみ等に起因する。この課題に対して、TFTの形状を

コの字型にする構造が提案されているが、このような構 造をとった場合、1画素内でのTFTの占める面積が大 きくなり開口率の低下を招くという問題があった。

【0035】本発明は、前記従来技術の問題を解決する ものであり、TFTの寄生容量のばらつきをなくし表示 品質を向上させ、液晶パネルの開口率が大きく取れるT FTを提供することを目的とする。

[0036]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため に、本発明は、薄膜トランジスタのチャンネル領域下部 10 に走査電極を形成するようにパターンニングされたゲー ト電極と、液晶を駆動するため透明導電膜より成る画素 電極に画像信号を伝達するソース電極(あるいはドレイ ン電極)と、前記画素電極と接続されたドレイン電極(あ るいはソース電極)とを有する薄膜トランジスタにおい て、前記薄膜トランジスタのチャンネル保護膜は前記ゲ ート電極上にのみ形成され、前記ソース電極およびドレ イン電極が前記チャンネル保護膜を形成している領域の 対向する2辺のみとクロスオーバーして他の辺上には重 なっておらず、かつ前記ソース電極およびドレイン電極 20 は共に前記ゲート電極とも十字型にクロスオーバーとな る構造を有することを特徴とする。

【0037】また、薄膜トランジスタのチャンネル領域 下部に走査電極を形成するようにパターンニングされた ゲート電極と、液晶を駆動するため透明導電膜より成る 画素電極に画像信号を伝達する前記ソース電極(あるい はドレイン電極)と、前記画素電極と接続されたドレイ ン電極(あるいはソース電極)とを有し、前記チャンネル 領域を形成する半導体層が絶縁性基板の裏面からの露光 により前記ゲート電極上に自己整合的に形成される薄膜 30 トランジスタにおいて、前記ソース電極およびドレイン 電極がともに前記チャンネル領域上で十字型にクロスオ ーパーとなる構造を有するように構成したものである。 [0038]

【作用】前記構成によれば、TFTのゲート電極におけ る部分と、ソース電極およびドレイン電極とがすべて十 字型となるクロスオーバーの構造を採用することによっ て、マスクのアラインメントずれに起因する寄生容量の ばらつきがなくなる。

[0039]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の一実施例を詳 細に説明する。

【0040】図1は本実施例1のチャンネル保護型のT FTの平面構造図を示す。また、従来例の各図にて説明 した同一作用効果のものには同一符号を付し、その詳細 な説明は省略する。

【0041】本実施例1はTFT3のチャンネル上に保 護膜を残したチャンネル保護型のTFT3の場合の例で ある。図1において、C1、C2はソース電極9と図5 (k)に示した半導体層12のコンタクト部、C3, C4は

ドレイン電極10と半導体層12のコンタクト部、C5はチ ャンネル保護膜13′とソース電極9,ドレイン電極10と のコンタクト部である。図2は寄生容量を含めたTFT 3の等価回路を示している。

【0042】液晶パネルの作成プロセスは従来のプロセ スと同一で、TFT3のチャンネル保護膜13′はゲート 電極8上にのみ形成され、前記ソース電極9およびドレ イン電極10がチャンネル保護膜13′の形成している領域 の対向する2辺のみとクロスオーパーし、他の辺上には 重なっておらず、かつソース電極9およびドレイン電極 10と共にゲート電極8と十字型にクロスオーバーしてい

【0043】前記の構成により、TFT3部分に発生す る寄生容量の値はマスクのアラインメント精度によらず 一定とすることができる。この理由について説明する と、図1(a)において図2に示すゲート-ソース間の寄 生容量Cgsは斜線部のGS領域S1で示した領域であ る。同様にゲートードレイン間の寄生容量Cgdは斜線部 のGD領域S2で示した領域となる。

【0044】この構造を採用することによりアクティブ マトリクス基板作製時において、図1(b), (d)に示すよ うに矢印方向にマスクのアラインメントずれが生じた場 合でもC1~C5の領域は変わらず、ゲート-ソース間 の寄生容量Cgsおよびゲートードレイン間の寄生容量C gdは常に斜線部のGS領域S1, GD領域S2となり、 ずれの方向および量に関わらず常に一定値となる。

【0045】このことから、アクティブマトリックス基 板作製時において、フォトマスクあるいはステッパー等 の精度に起因するような露光ショット領域の境界におけ るつなぎ合わせ部分のラインは消失し、表示品位の高い 液晶パネルを実現することができる。

【0046】次に、実施例2について図面を用いて説明 する。実施例2は液晶パネルの作製プロセスの中で、半 導体層12のパターンを絶縁性基板の裏面からの露光によ りゲート電極8の形状と同一形状に作製する自己整合型 のTFT3の場合である。図3は実施例2の自己整合型 のTFT3の平面構造図を示す。

【0047】ここで、従来例との違いはTFTアレイの 基板設計のパターンとして、図3(a)に示すようにチャ ンネル領域13″上でのゲート電極8とソース電極9およ びゲート電極8とドレイン電極10が共に十字型にクロス オーバーする構造を持つように設計したものである。こ の場合のゲートーソース間の寄生容量Cgsは斜線部で示 したGS領域S1である。同様にゲートードレイン間の 寄生容量Cgdは斜線部で示したGD領域S2となる。

【0048】 したがって、図3(b) に示すように矢印方 向にマスクのアラインメントずれが生じた場合でも、ゲ ートーソース間の寄生容量Cgsおよびゲートードレイン 間の寄生容量Cgdは常に斜線部のGS領域S1, GD領 50 域S2となり、いずれの方向および量に関わらず、常に

一定値となる。これにより実施例1と同様に、露光ショ ット領域の境界におけるつなぎ合わせ部分のラインは消 失し、表示品位の高い液晶パネルを実現することができ る。

[0049]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 チャンネル保護膜をゲート電極上に形成したチャンネル 保護型TFTの場合、ソース電極およびドレイン電極が チャンネル保護膜の形成している領域の対向する2辺の みとクロスオーバーし他の辺上には重なっておらず、か 10 つソース電極およびドレイン電極ともゲート電極と十字 型にクロスオーバーしている。以上の構成により、前記 のTFT部に発生する寄生容量の値はマスクのアライン メント精度によらず一定とすることができる。

【0050】また、自己整合型TFTの場合も、ゲート 電極とソース電極およびゲート電極とドレイン電極が共 にチャンネル領域上で十字型にクロスオーバーの構造と すれば、寄生容量の値はマスクのアラインメントずれが 生じた場合でも、ずれの方向および量に関わらず、常に 一定値となる。

【0051】以上のことから、本発明のTFTを用いて 寄生容量のばらつきをなくし、表示品質を向上した開口 率を大きくとれる液晶パネルができるという効果を奏す る.

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1におけるチャンネル保護型薄 膜トランジスタの平面図である。

【図2】寄生容量を含めた薄膜トランジスタの等価回路

を示す図である。

【図3】本発明の実施例2における自己整合型薄膜トラ ンジスタの平面図である。

R

【図4】従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置の 液晶パネル部を模式的に示した透視図である。

【図5】従来の液晶パネルのチャンネル保護型薄膜トラ ンジスタアレイの作製プロセスを示す断面図である。

【図6】従来の液晶パネルのチャンネル保護型薄膜トラ ンジスタアレイの作製プロセスを示す平面図である。

【図7】従来の自己整合型薄膜トランジスタアレイの作 製プロセスを示す断面図である。

【図8】従来の自己整合型薄膜トランジスタアレイの作 製プロセスを示す平面図である。

【図9】従来のチャンネル保護型薄膜トランジスタの平 面図である。

【図10】従来の自己整合型薄膜トランジスタの平面図 である。

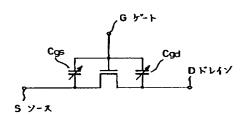
【図11】 基板内で寄生容量がばらついた場合に発生す る露光境界での境界線を示す図である。

【符号の説明】 20

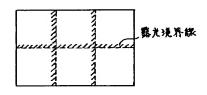
3…TFT(薄膜トラ 1…走杳線、 2…データ線、 ンジスタ)、 4…画素電極、 4′…ITO膜層、 5…ガラス基板、 6…対向電極、 7…対向基板、 8′…Cr層、 8…ゲート電極、 9…ソース電極、 10…ドレイン電極、 11…絶縁層、 12…半導体層、 13…チャンネル保護層、 13′…チャンネル保護膜、 13" …チャンネル領域、 14…オーミック層、 15…

穴、 16…A1層。

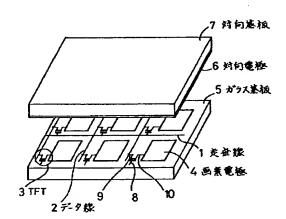
[図2]

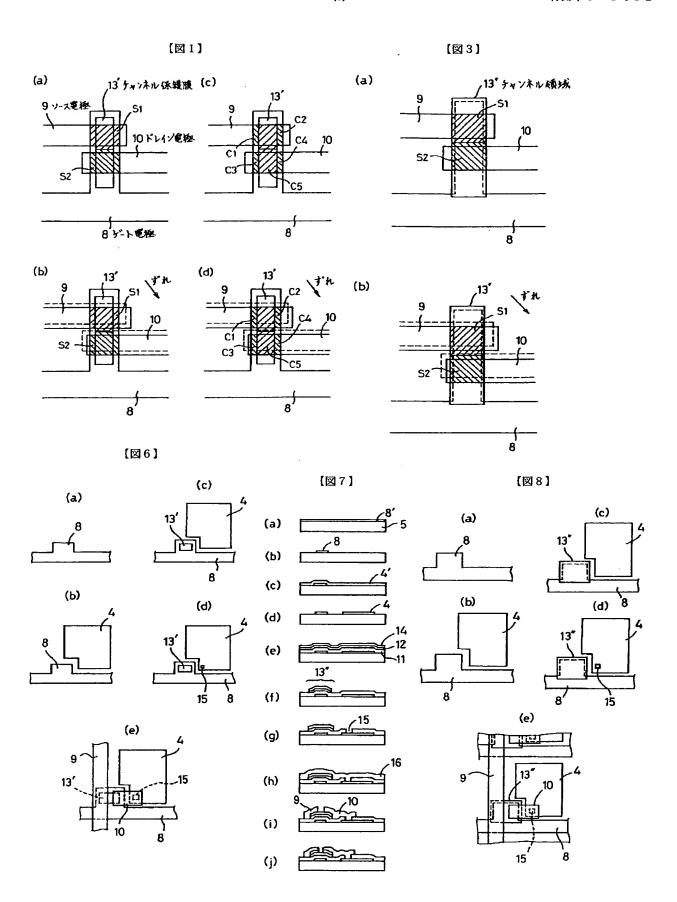


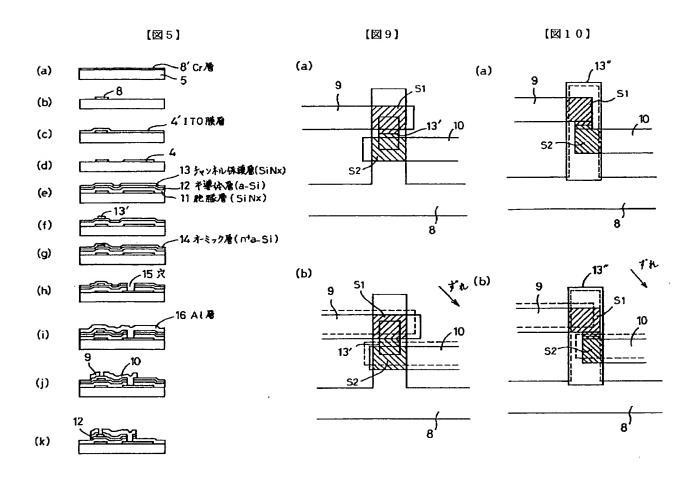
【図11】



【図4】







フロントページの続き

(72)発明者 木村 睦 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 田窪 米治 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内